

编辑计划

FEB / MAR		APR / MAY		JUN / JUL	
出版: Mar 8 物料: Mar 1		广告: Feb 23 投稿: Feb 20		出版: Jun 11 物料: Jun 3	
广告: Feb 23 投稿: Feb 20		出版: Apr 18 物料: Apr 11		广告: May 27 投稿: May 15	
封面故事	光刻和图案化	硅光集成		3D集成/异构集成	
技术专题	先进封装	检测/分析/测试		先进工艺设备/先进工艺控制	
专栏	材料 / 化学品 / 气体	MEMS/传感器		芯片设计工具 / 软件 / 平台	
特别报告	人工智能和机器学习	功率电子		IP, Chiplets, SoC, SiP, PoP.....	

AUG / SEP		OCT / NOV		DEC / JAN	
出版: Aug 20 物料: Aug 12		出版: Oct 25 物料: Oct 18		出版: Dec 23 物料: Dec 16	
广告: Aug 5 投稿: Jul 25		广告: Oct 11 投稿: Sep 27		广告: Dec 9 投稿: Dec 2	
封面故事	晶圆工艺	沉积/刻蚀/清洗		封装 / 组装	
技术专题	智能制造/ 数据工具/ 制造执行系统	CMP/ CMP后清洗		Chiplet堆叠 / 系统技术协同优化	
专栏	互连/ RDL / TSV	工艺集成		AI及 IC制造	
特别报告	存储技术	汽车半导体		供应链/ 可持续发展	

● 电子快讯计划		● 资源中心	
Jan	10 24	Apr	10 24
Feb	6 22	May	14 28
Mar	12 28 15	Jun	12 26 18
		Jul	10 24
		Aug	14 28 20
		Sep	12 26
		Oct	15 29
		Nov	12 26 18
		Dec	12 26

展会派发

FEB / MAR

- SEMICON China, 上海, 3月20-22日
- Productronica China, 上海, 3月22-24日
- EDICON 北京, 4月

APR / MAY

- Nepcon China/ EMT China 上海, 4月24-26日
- Chip China/CS China, 苏州, 5月

JUN / JUL

- STCon, 苏州, 6月

AUG / SEP

- CIOE, 深圳, 9月
- Chip China/CS China, 太仓, 10月

OCT / NOV

- Nepcon Asia, 深圳, 11月
- Chip China, 厦门, 11月
- SSL China, 厦门, 11月
- Productronica S China, 深圳, TBA

